



GAP PAD®

Tepelně vodivé podložky

GAP-PAD HC3.0 3.2

Gap Pad HC 3.0 vodivá podložka



- Tepelná vodivost 0,8 - 5 W/mK
- Elektricky nevodivý
- Tloušťky 0,5 - 6,5 mm
- Dlouhodobě flexibilní
- Výhodné pro opravy



POPIS PRODUKTU

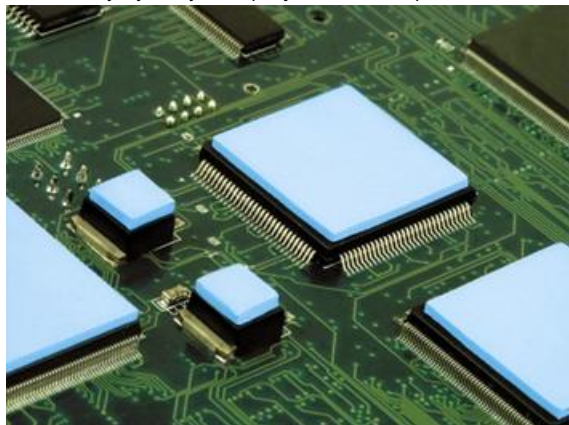
Gap Pad® - tepelně vodivá, elektricky nevodivá flexibilní podložka se používá všude tam, kde potřebujete vyplnit prostor a odvádět teplo. Díky své flexibilitě a tloušťce lze třeba umístit mezi tištěný spoj a chladič, materiál se přizpůsobí nerovnostem povrchu (SMD součástky, vývody, vodiče ap.) a účinně odvádí teplo z celého povrchu tištěného spoje. Gap Pad zůstává dlouhodobě flexibilní a eliminuje tepelnou roztažnost okolních součástí. Pracovní teplota je od -60°C do 200°C

Na rozdíl od zalévacích hmot nemusíte řešit "uzavření prostoru" a dobu vytvrzení materiálu, je daleko jednodušší případná oprava zařízení a díky možnosti selektivního použití můžete snížit hmotnost zařízení.

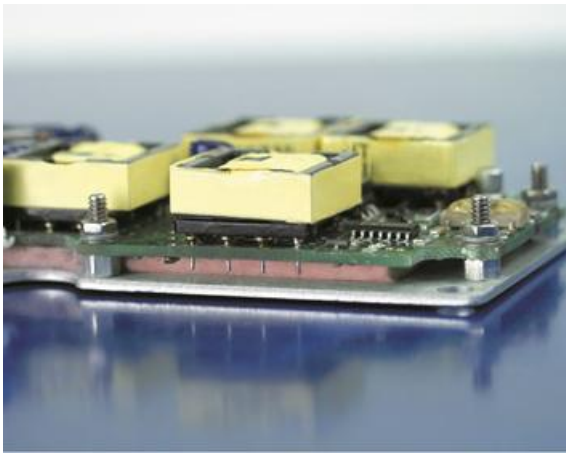
Tepelně vodivé podložky dodáváme v různých tloušťkách, tvrdostech, s různou tepelnou vodivostí a v různých formátech dle požadavku zákazníka.

Příklady použití:

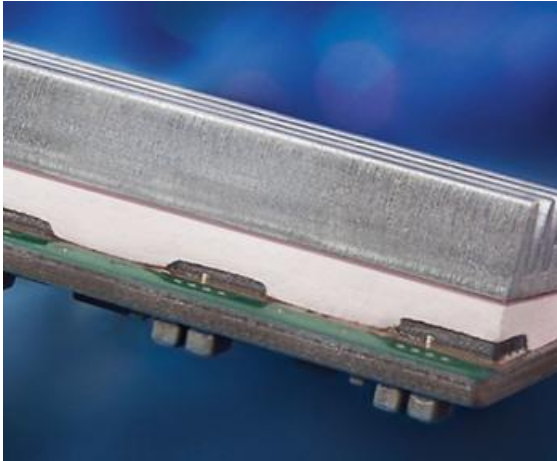
Eliminace výšky různých IO pro jeden chladič / pouzdro



Chlazení celého tištěného spoje



Globální chlazení IO

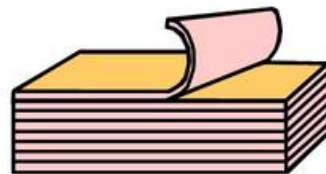


Materiál jsme schopni dodat v několika podobách dle potřeby zákazníka

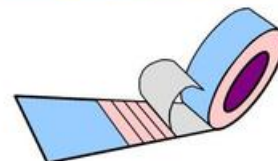
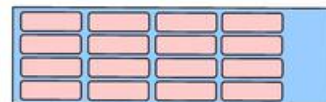
V dolní tabulce jsou uvedené nejpoužívanější typy
Materiál lze objednat v různých tloušťkách až do 6,5 mm

Materiál jsme schopni dodat v několika podobách dle potřeby zákazníka

Standardizované archy 8" x 16" (20,32 x 40,64 cm)



Standardizované či zákaznické výseky



Některé materiály v rolích (na poptávku)

